



各 位

平成 15 年 1 月 27 日

平成 15 年 3 月期 第 3 四半期の業績等の概況

上 場 会 社 名 **メック株式会社** 上場取引所 大阪証券取引所(ニッポン・ニューマーケット-「ハラクス」市場)

コ ー ド 番 号 4 9 7 1

本 社 所 在 地 兵庫県尼崎市昭和通 3 丁目 9 5 番地

(URL <http://www.mec-co.com/>)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 前田 和夫

問 合 せ 先 責 任 者 役職名 社長室長 氏名 坂本 佳宏

1 四半期損益計算書等の作成等に係る事項

財務諸表等の作成に際して準拠した基準	:(中間(連結)財務諸表規則)	
・会計処理方法の変更の有無	:有(内容)	⊖
・中間決算等と異なる会計処理の有無	:有(内容)	⊖
公認会計士又は監査法人による関与の有無	:有(内容)	⊖

2 業 績

(注)百万円未満切捨て

(1)平成 15 年 3 月期 第 3 四半期(平成 14 年 4 月 1 日~平成 14 年 12 月 31 日)の連結業績

	平成 15 年 3 月期 第 3 四半期 (当四半期)	対前年同 期増減率	平成 14 年 3 月期 第 3 四半期 (前年同四半期)	参 考 前 期 (通 期)
	百万円	%	百万円	百万円
売 上 高	4,106	6.5	3,854	5,228
営 業 利 益	519	44.8	358	518
経 常 利 益	474	41.1	336	530
当 期 純 利 益	244	-	-	289

(注)記載金額は、平成 15 年 3 月期第 3 四半期までの連結の業績であり、単体の業績につきましては、「4
その他 第 3 四半期の単体の業績」に記載しております。

(2)部門別の連結売上高内訳

	平成 15 年 3 月期 第 3 四半期 (当四半期)		対前年同 期増減率	平成 14 年 3 月期 第 3 四半期 (前年同四半期)		参 考 前 期 (通 期)	
	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
	百万円	%	%	百万円	%	百万円	%
電子基板用薬品	3,539	86.2	11.4	3,178	82.5	4,369	83.6
電子基板用機械	296	7.2	-33.9	448	11.6	563	10.8
電子基板用資材	201	4.9	3.7	194	5.0	252	4.8
そ の 他	69	1.7	109.5	32	0.9	43	0.8
合 計	4,106	100.0	6.5	3,854	100.0	5,228	100.0

(3) 主な資産・負債の変動について

項目	平成15年3月期 第3四半期	増減額	前期末
(資産)	百万円	百万円	百万円
現金及び預金	1,306	-464	1,770
受取手形及び売掛金	1,920	116	1,803
建物及び構築物	1,164	460	704
建設仮勘定	-	-303	303
投資有価証券	144	-69	214
(負債)			
短期借入金	635	-119	754
役員退職慰労引当金	240	-235	476

(注) 1.項目ごとの変動額が、総資産額の1%を超えるものを記載いたしております。

3 業績の概況

当社の製商品は、携帯電話やパソコン等の情報通信機器を始め、各種のデジタル家電や自動車、医療検査機器などのエレクトロニクス製品に搭載されている電子基板の製造工程で使用されております。

当四半期における当社の経営環境は、緩やかな回復段階となりました。日本国内のエレクトロニクス産業においては、一部に回復傾向を示している分野もあるものの、為替動向など不確定要素や個人消費、民間設備投資とも盛り上がり欠け、全体的には依然として厳しい状況が続いております。一方、中国市場に関しては携帯電話の加入者の急増に示されるように市場が拡大しており、今後数年間はこの傾向が持続していくものと考えております。

当社の顧客市場である電子基板業界に関しても、携帯電話向けのフレキシブル電子基板やMPU用パッケージ基板等部分的には明るさが見え始めましたが、総じて不透明な状況が続いております。また、顧客企業の生産活動の中国へのシフトも引続き進んでおります。

このような状況下において当社では、フレキシブル基板や汎用品電子基板向け新製品開発の一層の強化と共に、中国における販売を軌道に乗せるべく経営資源の集中を行っております。

当四半期における連結業績の概要は次のとおりであります。

(1) 売上高

当四半期までの合計売上高(平成14年4月1日から平成14年12月31日までの9ヶ月累計、以下同じ)は、41億6百万円(前年同期比6.5%増)となりました。このうち、電子基板用薬品の売上高は、35億39百万円(前年同期比11.4%増)となりました。パソコンMPU用パッケージ等の高密度電子基板用途での販売割合が高い銅表面超粗化剤CZシリーズを含む銅表面処理剤は比較的堅調に推移し、21億円(前年同期比17.5%増)となりました。その他、銅表面を有機皮膜で保護する防錆剤は4億64百万円(前年同期比15.5%増)、銅表面をはんだで保護する際に用いるフラックス剤が6億96百万円(前年同期比6.0%増)、はんだを溶解除去するメタルレジスト剥離剤が1億99百万円(前年同期比14.6%減)となりました。

電子基板用機械の売上高は、2億96百万円(前年同期比33.9%減)と引続き設備投資低迷の影響を受ける結果となりました。

(2) 営業利益および経常利益

電子基板用薬品が緩やかな回復基調となったために、営業利益は5億19百万円(前年同期比44.8%増)となりました。経常利益は4億74百万円(前年同期比41.1%増)となりました。

4 当期の見通し

通期(平成14年4月1日～平成15年3月31日)の見通しにつきましては、平成14年11月12日付の中間決算短信で公表いたしました連結・単体業績予想と同一であり、下記の通り現時点での変更はございません。

平成15年3月期の連結業績予想(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	5,577	611	320

(参考) 1株当たり予想当期純利益(連結) 62円 95銭

平成15年3月期の業績予想(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通期	4,286	339	186	15 00	15 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 36円 63銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことはお差し控え下さい。

5 その他

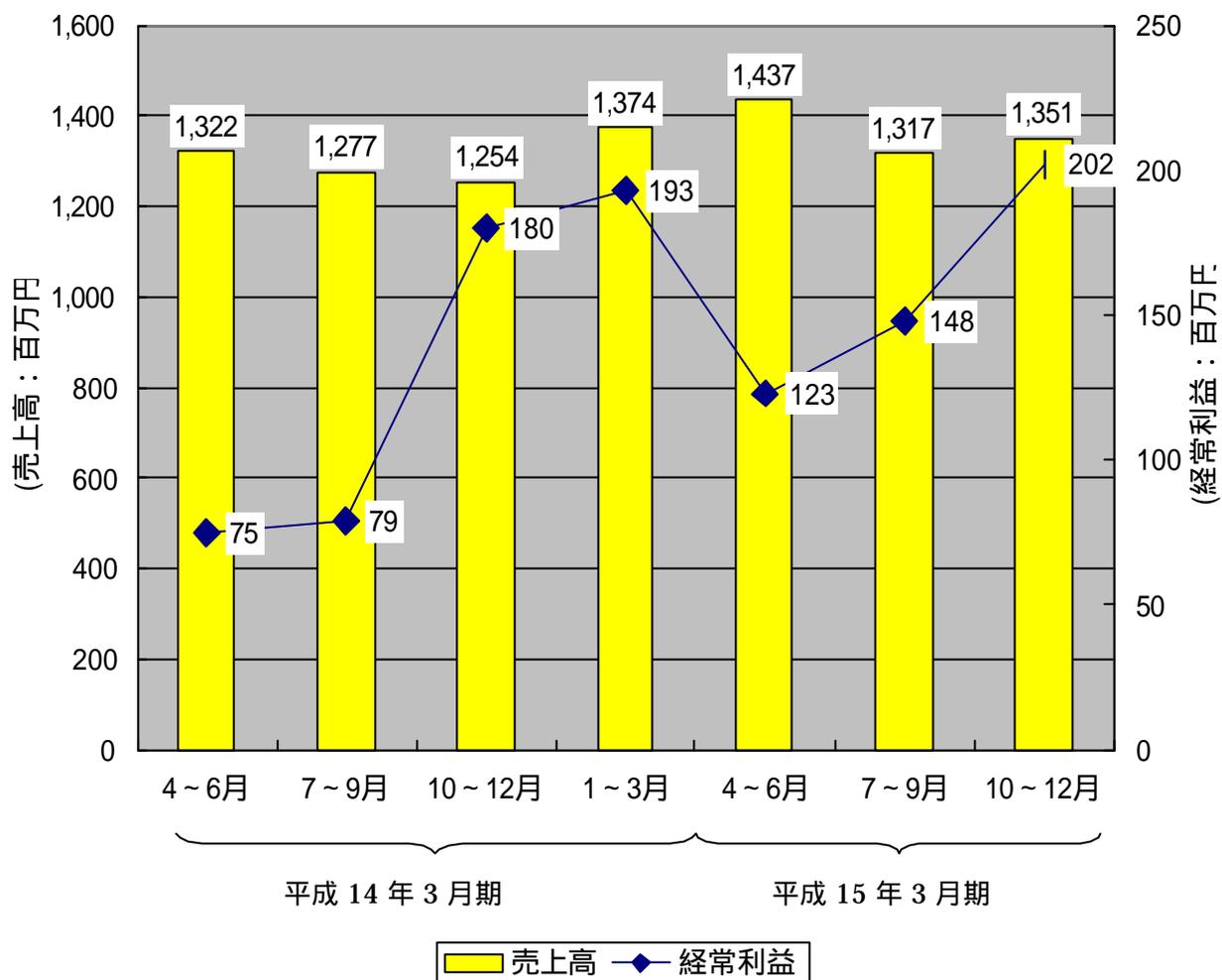
第3四半期の単体の業績(平成14年4月1日～平成14年12月31日)

	平成15年3月期 第3四半期
	百万円
売上高	3,170
営業利益	311
経常利益	238
当期純利益	126

以上

(ご参考)

四半期毎の連結業績推移



期間	平成14年3月期				平成15年3月期					
	4月1日~6月30日	7月1日~9月30日	10月1日~12月31日	1月1日~3月31日	4月1日~6月30日	7月1日~9月30日	10月1日~12月31日			
売上高(百万円、%)	1,322	1,277	1,254	1,374	1,437	8.7	1,317	3.1	1,351	7.8
営業利益(百万円、%)	78	101	178	159	157	99.9	147	45.3	214	20.3
経常利益(百万円、%)	75	79	180	193	123	62.0	148	87.2	202	12.1

注 平成15年3月期の%数値は対前年同期増減比を示しております。